

IDC Leiterplattenverbinder RM 1,27mm - Diagonalraster IDC Printed Circuit Connectors, 1.27mm Pitch - Diagonal Grid

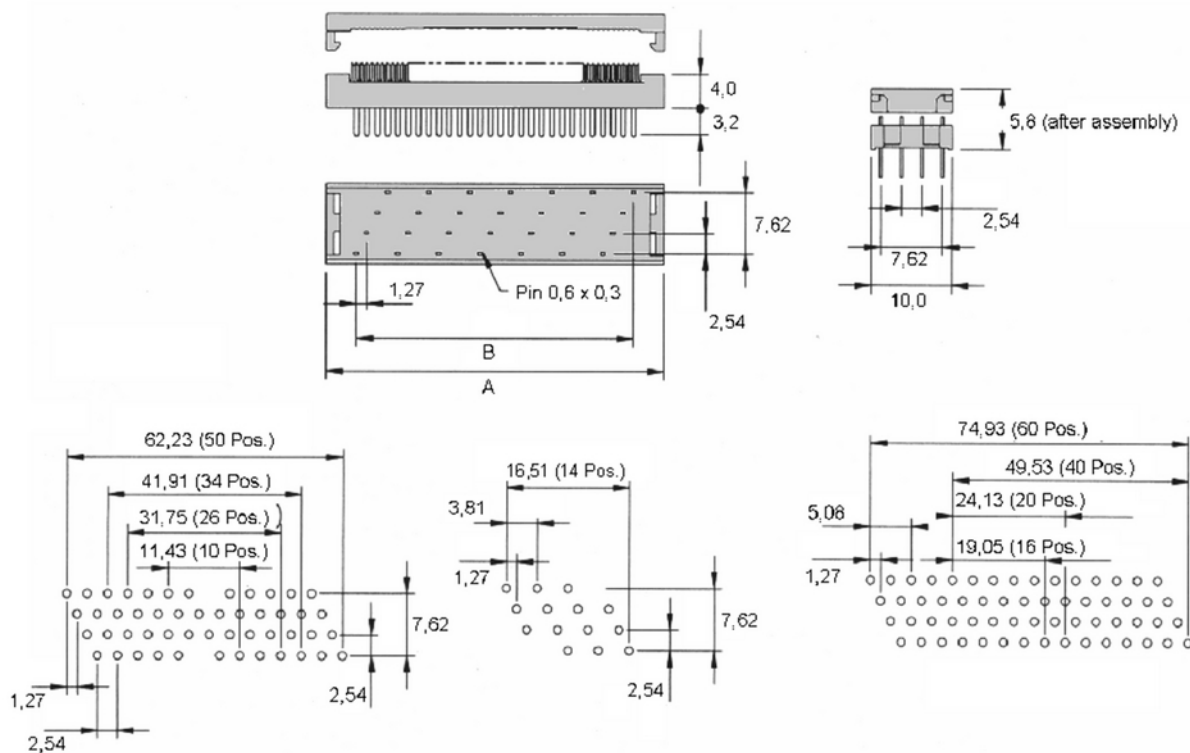
Technische Daten / Technical Data

Isolierkörper	Thermoplastischer Kunststoff, nach UL94 V-0
Insulator	Thermoplastic, rated UL94 V-0
Kontaktmaterial	Kupferlegierung
Contact Material	Copper alloy
Kontaktfläche	Lt. Oberflächenoptionen, über Ni (1,3 ... 2,5µm)
Contact Surface	Acc. to options (see below), over Ni (1.3 ... 2.5µm)
Lötbarkeit	IEC 60512-12A
Solderability	IEC 60512-12A
Durchgangswiderstand	< 20mΩ
Contact Resistance	< 20mΩ
Isolationswiderstand	> 1000MΩ
Insulation Resistance	> 1000MΩ
Spannungsfestigkeit	500V _{AC}
Test Voltage	500V _{AC}
Nennstrom	1A
Current Rating	1A
Temperaturbereich	-40°C ... +105°C
Temperature Range	-40°C ... +105°C
Verarbeitung	Wellenlötverfahren
Processing	Wave soldering



© W+P PRODUCTS

Passendes Flachbandkabel / Mates with Flat Cables:
356-1-287-xx / 356-2-287-xx



Series

628

Contacts*

14

10	A=17,50 B=11,43mm
14	A=22,58 B=16,51mm
16	A=25,12 B=19,05mm
20	A=30,20 B=24,13mm
26	A=37,82 B=31,75mm
34	A=47,98 B=41,91mm
40	A=55,60 B=49,53mm
50	A=68,30 B=62,23mm
60	A=81,00 B=74,93mm

Plating*

60

50 Verzinkt
Tin plated
60 Sel. Au/Sn
Duplex Plating

* Dies ist ein **Bestellbeispiel** - bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.
* This is an **order example** - please replace by your specifications.

TEL +49 5223 98507-0
FAX +49 5223 98507-50

W+P PRODUCTS

E-MAIL sales@wpro.com
WEBSITE www.wpro.com

Informationen zum Wellen-Lötverfahren Wave Soldering Information

Empfehlungen für das Wellenlötverfahren Recommendations for Wave Soldering

Die Bauteile sollten bei einer Lötbadtemperatur von 260°C in max. 5 Sekunden verlötet werden.
Items should be soldered at a solder temperature of 260°C in 5 seconds max.

Empfohlenes Wellenlötprofil:
Recommended wave soldering profile:

